

## Applicazione automatica di guarnizioni

Sonderhoff presenta al Midest di Lione la nuova tecnologia Formed-In-Place Closed Cell (FIP CC) con processo di schiumatura fisica.

5 marzo 2019 08:31

Sonderhoff, società del gruppo Henkel attiva nella fornitura di tecnologie per guarnizionatura, incollaggio e resinatura (Formed-In-Place, FIP), espone in questi giorni al salone Midest di Lione una cella di miscelazione e dosaggio Smart-M allestita per applicare in modo completamente automatico e preciso una miscela poliuretanicica liquida ad una lampada LED di segnalazione.



"Il sistema di schiuma Fermapor K31 reagisce a temperatura ambiente sul componente per formare una guarnizione in schiuma morbida - spiega Philippe Ott, reponsabile commerciale per l'Europa occidentale di Sonderhoff -. E poiché viene applicato in forma liquida, l'inizio e la fine della guarnizione fluiranno l'uno nell'altro creando una tenuta senza punto di giunzione visibile". "I componenti - aggiunge - saranno così protetti da pioggia, ghiaccio e neve, freddo, caldo, polvere e vento, nonché da influenze meccaniche".

La guarnizione può essere applicata al componente in modo completamente automatico e preciso - afferma l'azienda - e ciò rende il processo FIP più economico rispetto all'inserimento manuale di una guarnizione. Il materiale, inoltre, può essere utilizzato al 100% e non ci sono rifiuti.

La comprimibilità della guarnizione in schiuma compensa anche le tolleranze di produzione e grazie all'indurimento delle mescole a temperatura ambiente di evitano i costi di investimento per i forni e i relativi oneri energetici.